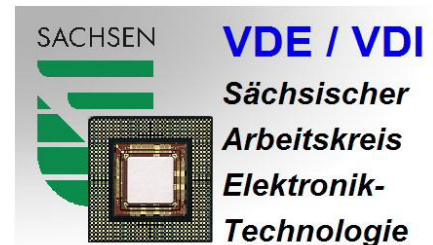


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
01069 Dresden
e-mail: bauer@htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann, TU Dresden
e-mail: martin.oppermann@tu-dresden.de



67. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie



Thema: **Sichere Verbindungen für die Elektronik**

Am **Mittwoch, den 8. Juni 2016** bei der **WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG**.

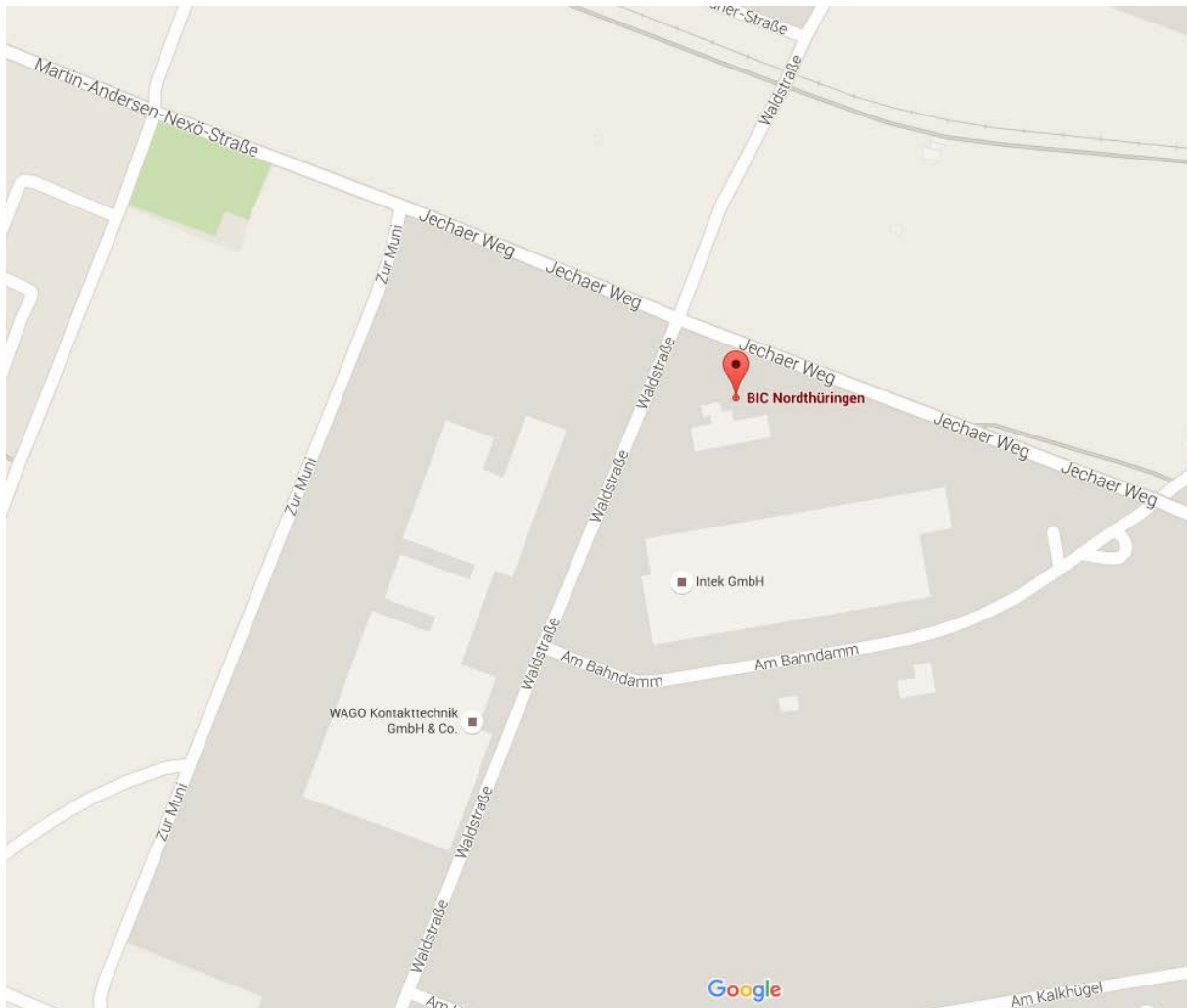
Programm:

- 09:30 Uhr Begrüßung
Herr Mario Meyer & Herr Prof. Reinhard Bauer
- 09:45 Uhr Firmenvorstellung WAGO + Vorstellung Fa. May
Herr Mario Meyer, WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 10:00 Uhr IR-SimpleCam – Inline-fähige Thermografie für die Elektronikfertigung: Eine kurze Projektvorstellung
Herr Dr. Martin Oppermann, TU Dresden, ZmP
- 10:10 Uhr Technologieworkshop Leiterplattenanschlusstechnik
Herr Matthias Giese, WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
- 11:00 Uhr Werksführung
- 12:30 Uhr *Mittagspause*
- 13:20 Uhr Abfahrt zum Schacht / Einweisung
- 14:00 Uhr Einfahrt in das Erlebnisbergwerk „Glückauf“
- 16:00 Uhr *Geplantes Ende*

Die Organisation bei der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG hat freundlicher Weise Herr Mario Meyer übernommen. Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Raumkapazität und der Planung der Einfahrt ins Bergwerk begrenzt ist, bitten wir unbedingt um **rechtzeitige Anmeldung bis spätestens Montag, den 30. Mai 2016** bei Herrn Dr. Oppermann (martin.oppermann@tu-dresden.de). Die Registrierung erfolgt nach Datum des Email-Eingangs.

Veranstaltungsort / Adresse (ACHTUNG! Abweichend von der Firmenadresse):

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG
Tagungsraum im Business and Innovation Centre (BIC) Nordthüringen GmbH
Waldstraße 2
99706 Sondershausen



Link zur WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG:

<http://www.wago.de//wago/standorte/wago-deutschland/sondershausen/uebersicht/index.jsp>